

# 什么是COB小间距显示屏？

产品名称	什么是COB小间距显示屏？
公司名称	深圳市康普信息技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦A1104、A1104-1、A1104-2、A1104-3
联系电话	0755-21038002 18565839923

## 产品详情

迈芯维COB（Chip-on-Board），也称为芯片直接贴装技术，是指将裸芯片直接粘贴在印刷电路板上，然后进行引线键合，再用有机胶将芯片和引线包封保护的工艺。和常规工艺相比，本工艺封装密度高，工序简便。迈芯维cob小间距，是1.0以下点间距的统称，因为SMD封装的led显示屏在做到1.0mm以下间距难以突破，所以有了cob。cob和SMD都是封装方式，区别就在于，cob封装流程简便，没有过多限制，间距可以做到更小；SMD封装受物理极限限制，无法完成更小间距的实现。JRCLED晶锐创显COB技术的优点：1、性能更优越：采用cob技术，将芯片裸die直接绑定在pcb板上，消除了对引线键合连接的要求，增加了输入/输出（I/O）的连接密度，产品性能更加可靠和稳定。2、集成度更高：采用cob技术，消除了芯片与应用电路板之间的链接管脚，提高了产品的集成度。3、体积更小：采用cob技术，由于可以在pcb双面进行绑定贴装，相应减小了cob应用模块的体积，扩大了cob模块的应用空间。4、更强的易用性、更简化的产品工艺流程：采用了集束总线技术，cob板和应用板之间采用插针方便互连，免除了使用芯片必须经过的焊接等工艺流程，降低了产品使用难度，简化了产品流程，同时使得产品更易更换，增强了产品易用性。5、更低的成本：cob技术是直接在pcb板上进行绑定封装，免除了芯片需要植球、焊接等加工过程的成本，且用户板的设计更加简单，只需要单层板就可实现，有效降低了嵌入式产品的成本。